

発表開始時間	発表終了時間	会場	セッションNO	発表順	セッション名	演題名	座長	氏名	所属	
10:25	10:30	U-ホール	ミッションフェローセッション		テーマ：SDGsに寄与する近い未来のソリューション					
10:30	11:00	U-ホール	5U	1	1	半導体を実現するカーボンニュートラル	土屋秀和（東海大学）	梅本清貴	ローム㈱	
11:00	11:30	U-ホール	5U	1	2	国産初の手術支援ロボット”hinotoriサージカルロボットシステム”	土屋秀和（東海大学）	東條剛史	㈱メディカロイド	
11:30	12:00	U-ホール	5U	1	3	企業価値向上のための脱炭素経営～GHG排出量算定ソリューション～	土屋秀和（東海大学）	渡慶次 道隆	㈱ゼロボード	
12:55	13:00	U-ホール	半導体再生特別セッション		テーマ：「緊急企画：日本半導体産業再生の最後の機会を逃さないために、今、後工程・実装業界がすべきこと」～今後の業界構造を激変させるMore Than Moore、チップレット、光電融合などの動きにどう備えるか～					
13:00	13:50	U-ホール	5U	2	1	国家戦略としての半導体再生、施策、企業はどう動くべきか（仮）	齊藤文靖（大阪公立大学）	新沼 祐	経済産業省	
13:50	14:30	U-ホール	5U	2	2	世界から見たパッケージ技術での日本の強みと今後のビジネスチャンスとリスク	齊藤文靖（大阪公立大学）	亀和田忠司	AZ Supply Chain Solutions	
14:30	15:10	U-ホール	5U	2	3	高性能デバイスを支える最先端パッケージ動向：チップレットを中心として	齊藤文靖（大阪公立大学）	西尾俊彦	㈱SBRテクノロジー	
15:25	16:05	U-ホール	5U	3	1	光電融合による高速実装技術の将来と要素技術（仮）	齊藤文靖（大阪公立大学）	石井 雄三	日本電信電話株式会社	
16:05	16:55	U-ホール	5U	3	2	More Than Mooreは半導体業界の再生の機会、チップレット化で激変の業界構造とモノづくり	齊藤文靖（大阪公立大学）	若林秀樹	東京理科大学	
17:00	18:00	U-ホール	5U	4	1	パネルディスカッション	齊藤文靖（大阪公立大学）	講演者、折井靖光（長瀬産業）、西田秀行（NEP Tech. S&S）		
12:55	13:00	A	第39回 電子デバイス実装研究委員会 ～カーボンニュートラルに向けた接合・実装技術～					(WEB配信なし)		
13:00	13:40	A	5A	1	1	循環型熱硬化性樹脂によるサーキュラーエコノミー戦略	高尾 尚史（豊田中央研究所）	内藤 昌信	(国研)物質・材料研究機構	
13:40	14:20	A	5A	1	2	リフトオフを生じない高耐久はんだ	高尾 尚史（豊田中央研究所）	森 公章、大谷 怜史、岡村 真	(株)弘輝	
14:30	15:10	A	5A	2	1	三次元実装の現状と課題	佐名川 佳治（パナソニック）	西田 秀行	NEP Tech. S&S	
15:10	15:50	A	5A	2	2	深層学習を利用した非破壊ではんだクラック三次元可視化と進展解析	佐名川 佳治（パナソニック）	長谷川 将司、植木 竜佑、高橋 政典	(株)クオルテック	
16:00	16:40	A	5A	3	1	AKROSEと拡散接合を組み合わせた接合技術「AKROSE HYBRID」の開発	井上 雅博（群馬大学）	手島 政和	日東精工(株)	